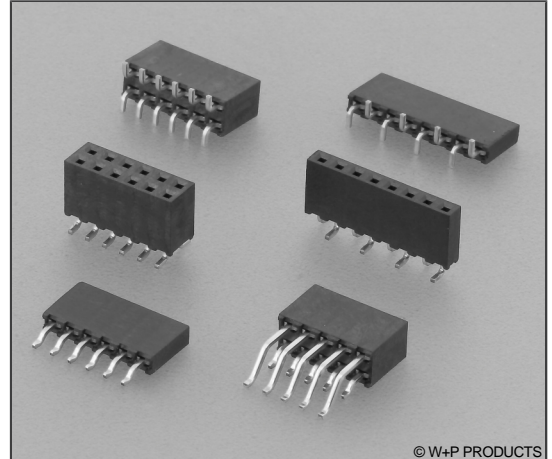


## SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig – BH 7,62mm SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows – 7.62mm Profile

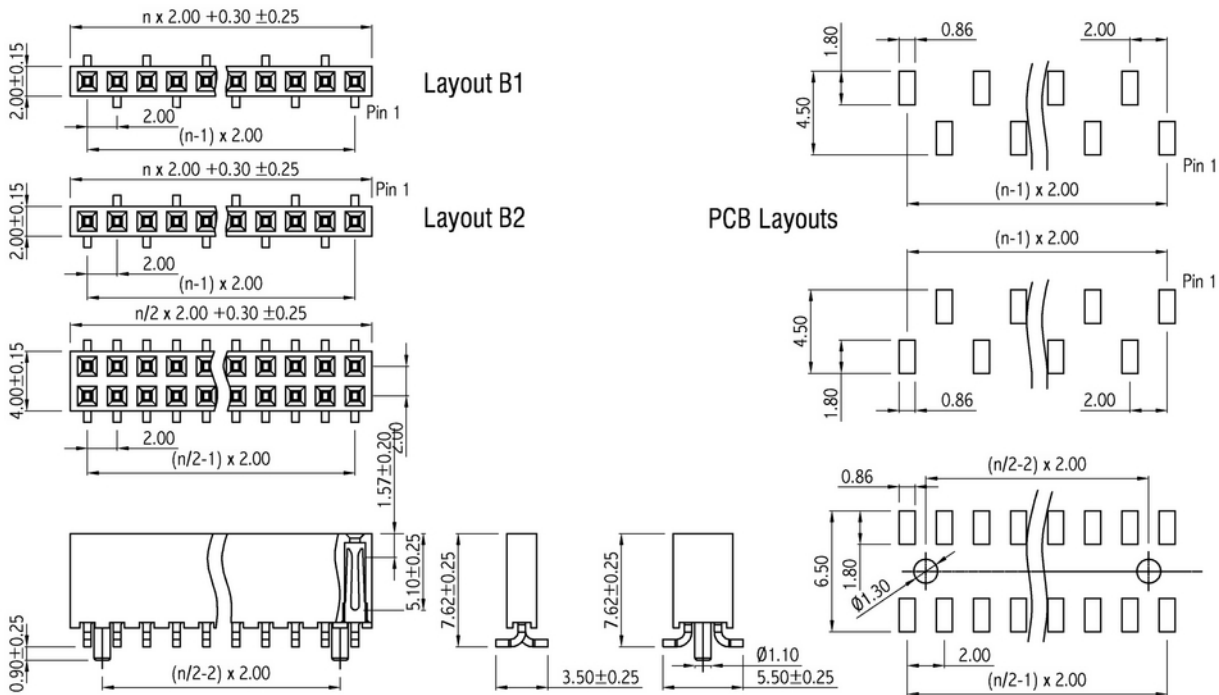
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

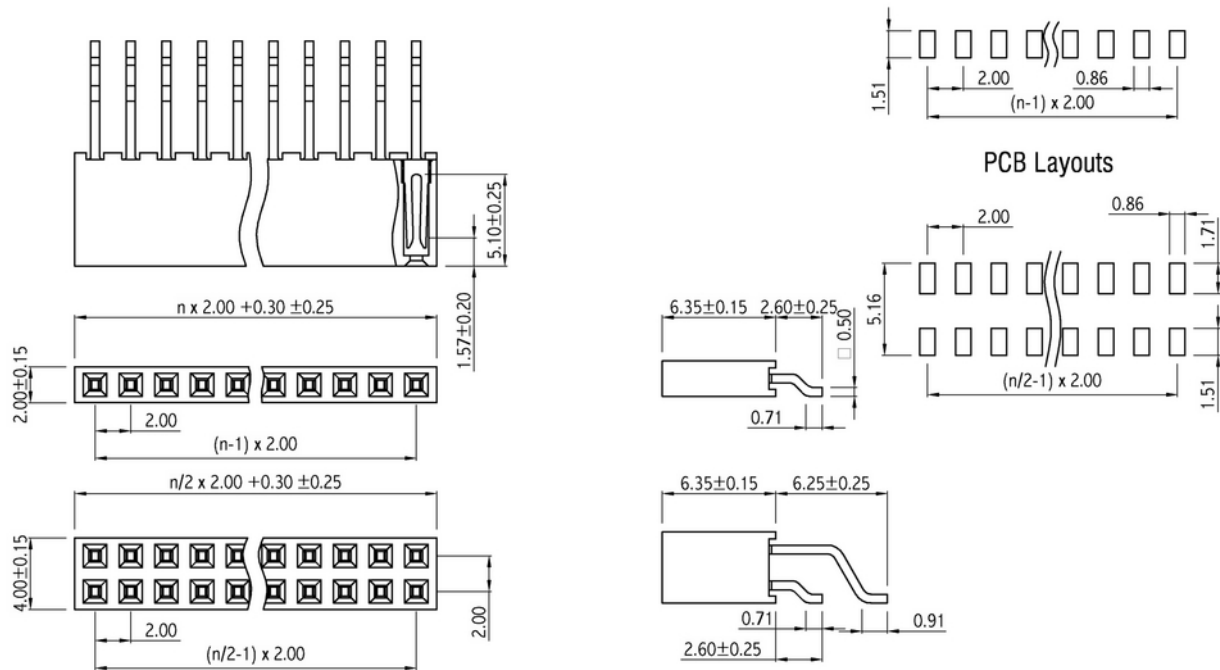
Gabelkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.  
Fork contacts accept 0.50mm square pins.



Series	Contacts*	Rows*	Type	Layout*	Plating*	Locating Pegs*	Packaging*
<b>4160</b>	<b>14</b> 03-30 Einreihig Single row 04-60 Zweireihig Double row	<b>2</b> 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	<b>1</b> 1 Stehend Vertical	<b>0</b> 1 Layout B1 2 Layout B2 0 (zweireihig) (double row)	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>10</b> 00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen (nur zweireihig) With loc. pegs (double row only)	<b>ST</b> ST PPST PPTR

# 4160

SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend/liegend, 1-/2-reihig – BH 7,62mm  
 SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical/Horizontal, 1/2 Rows – 7.62mm Profile



Series	Contacts*	Rows*	Type	Plating*	Packaging*
<b>4160</b>	<b>10</b> 02-30 Einreihig Single row 04-60 Zweireihig Double row	<b>2</b> 1 Einreihig Single Row 2 Zweireihig Double row	<b>2</b> 2 Liegend Horizontal	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>ST</b> ST TR

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** - please replace by your specifications.

#### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads  
**ST** In Stangen / In tubes  
**TR** Tape & Reel / Tape & Reel

### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

